



Ref. Certif. No.

JPTUV-024222

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT  
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

## CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product  
Produit

Switching Power Adaptor

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeur

XP Power Limited  
401 Commonwealth Drive,  
Haw Par Technocentre, Lobby B, #02-02, 149598, Singapore

Name and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricant

XP Power Limited  
401 Commonwealth Drive,  
Haw Par Technocentre, Lobby B, #02-02, 149598, Singapore

Name and address of the factory  
Nom et adresse de l'usine

See additional page(s)

Rating and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Input: AC 100-240V; 2A; 50-60Hz; Class I  
Output: refer to the test report.

Trade mark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

XP

Model/type Ref.  
Ref. de type

AMD150PSxyyzzzz  
(x = 12, 19 or 24; yy = C6 or blank; z = 0-9, A-Z, hyphen  
or blank)

Additional information (if necessary)  
Information complémentaire (si nécessaire)

For model differences, refer to the test report.

A sample of the product was tested and found  
to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été  
considéré conforme à la

IEC 60950-1:2001  
National differences see test report

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part  
of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de  
référence qui constitue une partie de ce Certificat

11014345 001


This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



TÜV Rheinland Japan Ltd.  
Global Technology Assessment Center  
4-25-2 Kita-Yamata, Tsuzuki-ku  
Yokohama 224-0021 Japan  
Phone + 81 45 914-3888  
Fax + 81 45 914-3354  
Mail: info@jpn.tuv.com  
Web: www.tuv.com

Date: 15.09.2008

Signature:

  
Dipl.-Ing. W. Hsu